



## VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan  
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | [www.viatech.com](http://www.viatech.com)

# VIA、Lucid と協業し、業界をリードする Qualcomm® APQ8096SG エンベデッドプロセッサ搭載 VIA Edge AI 3D 開発キットを開発 統合型 ソフトウェアおよびハードウェアソリューションにより、幅広いセキュリティ、店舗用 カメラ、ロボティクス、自律走行型車両向けデバイスの深度測定機能実装を加速

2018年11月14日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、セキュリティ、小売り、ロボティクス、自律運転型車両などの分野において、より多くのデュアルカメラまたはマルチカメラデバイスに AI ベースの深度測定機能を提供すべく、AI ビジョンのスタートアップ企業である Lucid と提携したことを発表いたしました。



Lucid 独自の 3D Fusion Technology を VIA Edge AI 3D 開発キットに組み込むことによって、セキュリティおよびリテールのカメラ、ロボット、無人機、自律運転型車両が、デュアルカメラまたはマルチカメラ搭載環境で正確な深度と 3D を簡単にキャプチャできるようになり、以前のハードウェア深度ソリューションのコスト、電力および接地面積を削減します。VIA の長期的なエッジ AI ソリューションロードマップに順じ、Lucid はあらゆるプラットフォーム上にカメラと機械学習ベースの深度測定機能を追加していきます。

3D Fusion Technology として知られる Lucid によって開発された AI 拡張 3D/深度ソリューションは、11月に発表されたばかりのエミッションまたはレーザーベースのハードウェア構成要素を必要としない RED Hydrogen One を含む、3D カメラ、セキュリティカメラ、ロボット、携帯電話などの多くのデバイスに導入されています。VIA Edge AI 3D 開発キットには、Qualcomm® APQ8096SG エンベデッドプロセッサで動作する AI 深度測定ソリューションが含まれ、Qualcomm® AI エンジンと複数のカメラをサポートしており、

Press Release

# VIA、Lucid と協業し、業界をリードする Qualcomm® APQ8096SG エンベデッドプロセッサ搭載 VIA Edge AI 3D 開発キットを開発 2/3

Lucid により、他のハードウェア深度測定ソリューションに比べて優れた性能を提供し、業界をリードするユニークな純粋な機械学習ベースのソフトウェアソリューションを実現します。

「VIA と Lucid は、このエキサイティングなパートナーシップを通じて、エッジ AI プラットフォームとシステム深度測定に必要な迅速なスケーリングに取り組んでいきます。その主な用途として、われわれはセキュリティカメラだけでなく、スマート小売、ロボット、ドローンおよび自律運転型車両に着目しています」と、VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP のリチャード・ブラウンは述べています。「このコラボレーションにより、VIA は統合ソフトウェアモジュールとして Lucid の AI ソリューションを使用し、カスタマイズ可能で組み込み可能な Edge AI 開発キット、システムおよびカメラを提供するハードウェア/ソフトウェアの組み合わせを実現します。これにより、深度測定機能の開発を開始するすべてのデバイスメーカーにとって、緊密に統合されたパッケージが提供されます」

今日の市場では、深度測定機能を備えたスマートカメラは、セキュリティ、小売、ロボット、IoT 業界において、ガラス越しの空間におけるより洗練された顔識別精度や、正確な物体認識、追跡、測定を可能にすることにおいて重要な役割を果たします。ロボット、ドローン、自律運転型車両の場合、深度測定機能により、空間を 3D でナビゲート、保存、再構築する機能が大幅に向上し、マシンの自律性を向上させます。現在のハードウェアソリューションであるエミッションベースおよびレーザーベースは、デバイスの総コスト、サイズ、消費電力に大きな影響を与えます。しかし、VIA と Lucid ソリューションは、これらの課題を排除するだけでなく、コスト、フォームファクタ、電力バジェットの大幅な削減を実現しつつ、深度測定機能を統合することで、システムのスケーリングと展開をスピードアップします。

Lucid の CEO 兼共同創業者の Han Jin 氏は「このパートナーシップは、コストとパフォーマンスの両方において優れたシステムを提供し、市場のデバイスメーカーに差し迫る苦勞を解決します」と述べています。「高価でかさばる従来のハードウェアベース深度測定ソリューションと比べ、IoT やデュアルカメラデバイスの幅広い開発労力も簡素化できます」

このコラボレーションを開始するにあたり、Lucid と VIA は米国時間の 11 月 14 日～15 日にニューヨークで開催される ISC East において VIA Edge AI 3D 開発キットのプロトタイプを展示する予定です。なお、VIA ブースは 659 です。

VIA Edge AI 3D 開発キットは、評価用サンプルの配布を開始しており、今年後半および 2019 年初に量産出荷を開始する予定です。

詳細については、[lucidinside.com](http://lucidinside.com) または [viatech.com](http://viatech.com) をご覧ください。

本リリースに関連する画像については、下記 URL をご参照ください。

<https://www.viagallery.com/via-lucid-edge-ai-3d-developer-kit/>

# VIA、Lucid と協業し、業界をリードする Qualcomm® APQ8096SG エンベデッドプロセッサ搭載 VIA Edge AI 3D 開発キットを開発

3/3

## VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc は、AI、IoT、コンピュータビジョン、自律型車両、ヘルスケア、スマートシティアプリケーション向けの高度に統合された組み込みプラットフォームおよびシステムソリューション開発における世界的リーダーです。台湾の台北に本拠を置く VIA のグローバルネットワークは、米国、欧州、アジアのハイテクセンターを結びつけています。その顧客基盤には、世界をリードする多くのハイテク、通信業界のブランド名が含まれています。 <http://www.viatech.com/>

## Lucid について

Lucid は、機械学習に基づいた 3D キャプチャと深度検知のためのソフトウェアソリューションを開発している大手 AI ビジョンスタートアップ企業です。3D Fusion Technology は、デュアル/マルチカメラの設定のみを利用して、携帯電話から、3D カメラ、ロボット、ドローン、セキュリティなどのスマートカメラシステムにいたるまで、数百万台のデバイスに導入されています。Lucid の簡単に統合可能な SDK により、標準的なカメラは、クラウド内でトレーニングを行い、エッジ側で深度を推測することで、コスト、スペース、開発期間において、エミッションベースのハードウェア深度測定システムよりも優れた性能を発揮します。詳細については、[www.Lucidinside.com](http://www.Lucidinside.com) をご覧ください。

## お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社  
メールアドレス: [mktjp@viatech.co.jp](mailto:mktjp@viatech.co.jp)

## 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)  
メールアドレス : [RIBrown@via.com.tw](mailto:RIBrown@via.com.tw)

## HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : [press@hanare-pr.jp](mailto:press@hanare-pr.jp)

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。

Qualcomm は、米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。  
Qualcomm APQ8096SG および Qualcomm AI エンジンは、Qualcomm Technologies, Inc. および/またはその子会社の製品です。  
本リリースに記載されている実際の企業および製品名は、それぞれの所有者の商標です。